

华润微电子有限公司

投资者关系活动记录表

(2026 年 5 月)

证券简称：华润微

证券代码：688396

投资者关系活动类别	☐特定对象调研☐分析师会议 ☐媒体采访☒业绩说明会 ☐新闻发布会☒路演活动 ☒现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	5 月 07 日 美银证券、国泰海通证券、风和基金、Maybank 05 月 13 日 华源证券、国海证券、国寿资产、Nature Capital、东方证券自营、中信证券资管、丰琰投资、九泰基金、人保资产、兴银基金、北京鹏石私募、华泰保兴基金、国寿安保基金、国泰海通资管、国联基金、天治基金、太平基金、富国基金、弘毅远方基金、招银理财、新华基金、民生加银基金、深圳铭海私募、瑞银基金、瞰道资管、惠升基金、泰康资产、平安养老、易方达基金、华泰保险、中信建投证券自营、泰康基金、淡水泉投资、海富通基金、国新投资、上海重阳投资 05 月 18 日 广发证券、景林资产、上海证券、中金资管、中颖投资、人寿养老、兴证全球基金、南方基金、平安基金、红塔证券、长信基金、瓴仁投资、博时基金、平安资产、新华资产、东方资管 05 月 26 日

	中信建投证券、中信证券、国联民生证券、国投瑞银证券、国新证券、宁波宝隼资管、上海古曲私募、广西投资集团、南京道富投资、华泰证券、华夏基金、兴全投资、兴全基金、北京汽车集团投资、泰康资产、博时基金、诺安基金、富国基金、长信基金、嘉实基金、国泰基金、招商基金、上银基金、中银基金、澄阳资产、高毅资产、中信资管、煜德投资、正心谷、幸福人寿、华夏久盈、柏治投资、健顺投资、南方天辰投资、诚旻投资、上海国资、新思哲投资、招银理财、国海富兰克林基金、招商信诺资产、高熵资产、风和投资、众安保险、TRUE LIGHT、勤辰资产、瀑布资产、美阳投资、嘉兴天季向荣股权投资、乐桥资本、太平资产、中信建投自营、和谕私募、重阳投资、澄明资本 05月29日 中金公司、CICC Asset Management、CIC、ENREAL ASSET、MOUNT EVEREST FUND、Manulife、Optimas Capital Limited、PICC AM、PINGAN、Passage Investment Management、Taikang AMC、VERITAS ASSET MANAGEMENT、Zestvale capital、CTF Life、Coreview Capital、Foundation Asset Management、HD capital、Pickers Capital、Willing Capital、Wolf Vest Capital Management Limited、上海宽远资产、北京汉和汉华资本、华能贵诚信托、南方基金、招商信诺资产、深圳前海辰星私募、深圳凯丰投资、深圳多和美投资
时间	05月07日、05月13日、05月18日、05月26日、05月29日
地点	无锡、上海、深圳、香港
上市公司接待人员姓名	吴国屹 华润微电子董事、财务总监兼董秘 沈筛英 华润微电子董事会办公室主任

投资者关系活动 主要内容介绍	问题一：请问公司产能利用率及订单能见度？ 答：公司当前产能与订单均处于饱满状态，待交订单规模持续攀升并创下新高。订单能见度最高达 9 个月，部分热门型号的待交订单周期已超过一年。 问题二：请问公司在产能持续饱满的情况下还有哪些弹性空间？ 答：短期来看，公司将继续优化产品组合，重点推广高毛利及新品类产品，深化客户服务，确保供应保障与价格策略有效落地。中长期来看，公司将加速新品的产业化导入，持续推行柔性运营，全面提升产品综合竞争力。 问题三：请问公司待交订单主要集中在哪些领域及产品？ 答：公司在重点平台、关键领域及重要大客户方面均实现了显著增长。得益于 AI 领域的高景气度与“算电协同”效应，应用于光储及新兴领域的 MOSFET、IGBT、第三代半导体及模块等产品，均呈现快速增长态势。 问题四：请公司重点介绍在新兴领域的业务进展情况？ 答：公司在新兴领域已实现多点突破，产业化进程快速放量。在低空经济方面，应用场景正向农业植保、应急救援、物流配送等领域加速扩容，有效带动核心功率器件及 MCU 等产品的需求增长。在机器人领域，工业及商业服务场景日益丰富，已实现对重点客户的导入与上量。在服务器领域，伴随电源系统向 800V HVDC 高压直流架构演进，公司功率器件及模块产品持续上量，栅极驱动产品的开发也在快速推进。此外，在 SST（固态变压器）架构下，公司 SiC 产品已取得销售突破并获得多家客户备货订单。 问题五：请问公司如何看待涨价的持续性？
---------------------------	--

	答：自调价通知发布以来，公司已与产品客户及制造服务客户进行专项沟通，调价策略推进有序。公司将充分利用当前产能紧张带来的有利时机，持续推进谈判工作，以核心产品为重心，逐步扩大涨价的覆盖范围。 问题六：请公司详细介绍面板级封装（PLP）工艺？ 答：PLP 封装的核心突破在于大尺寸面板的产业化应用。公司已成功解决 600mm×600mm 面板在翘曲、芯片偏移、图形对位及结构可靠性等方面的六大核心技术难题，封装良率稳定保持在 99.7%以上。该技术已广泛应用于 AI 服务器电源、手机及可穿戴设备的电源管理与逻辑电路、汽车微控制器等领域，同时正在与光模块领域头部客户合作开发新一代光模块电源驱动模块。公司具备从晶圆制造到封装测试的一站式特色服务能力，有助于增强客户粘性并构筑更高的技术壁垒。 问题七：公司在 SST 固态变压器领域的产品布局？ 答：公司在 SST 核心器件领域已形成完整布局。电压覆盖范围上，公司的 SiC MOS 单管与模块产品已覆盖 650V 至 2300V，更高电压等级的 3300V SiC MOS 亦在规划中。封装方面，已完成 Easy 系列、62mm 及 ED3 模块的布局。针对单相 500V 至 1.5kV 交流输入的应用场景，公司已开发 1200V 至 2300V 的 SiC 单管与模块，其中 1200V Easy 2B 4mR 模块已出样，AUX 电源所需的 1700V 及 2300V SiC 器件规格齐全，充分展示了公司在 SST 架构下布局的产品广度与技术深度。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 5 月